

2021 年度 WEB 決算説明会（2022 年 8 月 10 日開催）**およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【21 年度実績】****1. 4Q 実績が 3Q 時点で想定していたよりも上振れた理由は？**

A: 4Q 受注高は 3Q に想定していたよりも FPD・半導体電子など全体的に上振れた。
4Q 売上高については、3Q 時点では部材長納期化の影響により 3Q 実績と同様に推移すると見込んでいたが、顧客からの前倒し要請もあり、FPD 中心に製造工程が進捗したために、売上が上振れた。

**2. 売上総利益率が 29.4%から 30.6%に改善した要因は？ 品目毎の改善は？
売上増加の効果、モノづくり力強化の効果に分けるとどのような貢献度合いか？
売上総利益率が期初公表値に届かなかった理由は？**

A: 半導体、電子、FPD、一般産業、材料、その他など多くの品目で利益率が改善した。
売上高が 1,830 億円から 2,413 億円に増加した効果が大きく、モノづくり力強化による利益率改善効果は 2 割程度にとどまった。
モノづくり力強化による利益率改善に取り組んできたが、長納期部材の調達を優先せざるを得ず、標準化・部品共通化等によるコストダウンの効果が出にくかったことや部材長納期化により生産工程の組み直しや納品後の追加インストールが必要となるなど生産性改善の効果も減殺された影響が大きい。加えて、部材長納期化により利益率の高い半導体電子の売上貢献が遅れる一方、FPD の比率が増加したことによるミックスの悪化も売上総利益率が計画に届かなかった理由である。

3. 研究開発関連の設備投資が計画比少ないがなぜか？ 来期以降は増加するのか？

A: 21 年度は、長納期化部材の納入が遅れたために、設備投資額が計画を下回る結果となった。発注ベースでは計画に近い投資を行っている。
次期中期経営計画でも半導体・電子等を中心に更なる成長のための研究開発投資は増額していく方針。

4. 21 年度の FPD および半導体電子部品の受注高・売上高の用途別内訳は？

A: 別紙 1 のとおり。

5. 21 年度の営業利益率順位は？

A: 別紙 1 のとおり。

【22 年度計画】**6. 22 年度の売上総利益率は 21 年度の 30.6%から 33.0%に改善する計画だが、どのような要因で改善するのか？**

A: 全品目で利益率改善に取り組む。
部材長納期化の影響が当面続くと想定しており、モノづくり力強化による改善効果は限定的。売上増加による売上総利益率の改善と、半導体電子の売上貢献増加・FPD の売上減少によるミックス改善の効果が大きい。

7. 22年度計画の販管費が480億円となっており、21年度実績437億円比43億円の増加となるが、何が増えるのか？

A: 開発関連やシステム関連を中心に将来の成長に向けた必要経費として増加を見込む。

8. 22年度のFPDおよび半導体電子部品の受注高・売上高の用途別内訳は？

A: 別紙2のとおり。

【部材調達関連等】

9. どのような部材が長納期化しているのか？どのような対策を取っているのか？

A: 電子部品の入手難が続き、部材長納期化が部品から製品に範囲が拡大している。制御部品全般や電源、マスフローコントローラーなどが長納期化するとともに、部品製作サプライヤーでも需給逼迫によって長納期化が継続している。対策として、部品・材料の先行手配やサプライヤーの原材料手配協力、標準ユニットの早期部材確保、各メーカーとの定期的な打合せによる協力体制などに加え、海外グループ連携によるグローバルな部品確保の取組などを実施している。また、取引先や一部の顧客とも入手困難な部品情報を共有し、協力して部品確保に取り組んでいる。さらに仕様変更による部品置き換えも進めている。

10. 装置のリードタイムはどの程度伸びているのか？

A: 装置によっても異なるが、例えば半導体・電子では、様々な対応により6～8ヶ月程度に抑え込んでいたリードタイムが、部材の長納期化に伴い、足元では12ヶ月を超えるようになってきている。

11. 部材調達コスト上昇、物流コスト上昇による影響は？

A: 当社の装置ビジネスは、見積りごとに価格交渉を行うケースが多いことから、都度の価格交渉で吸収できる面がある。また、モノづくり力強化による利益率改善によって吸収している面もあるが、その分、利益率改善の進捗が遅れが出ている面がある。物流コスト上昇に関しては、顧客に製品を届ける際の物流費は、FOB等が多く顧客負担となるため、影響は比較的軽微である。

【半導体・電子 投資動向】

12. 半導体装置市場が 23 年にスローダウンすると見る向きが多いが、どのように考えているか？

A： 顧客の最新の投資計画を確認して計画を策定している。

当社の半導体装置市場におけるシェアはまだ小さいので、半導体装置市場の動きとは必ずしもトレンドが一致せず、むしろ顧客の新しい工程での採用などによる増加の影響が大きい。

ロジック MHM 工程への参入がキッカケとなり、ロジックのみならずメモリ分野でも他工程への参入のチャンスをもたらえるようになってきたので、これを活かして、市場の伸びを上回る成長を実現していきたい。

13. ロジック・メモリで、22 年度はどのような要因で伸ばす計画なのか？

A： 今期はロジック分野の受注高は、前年同期比 1.7 倍を計画している。MHM 工程を柱としつつ、既に採用が決まっている他工程の受注が貢献する。また、新規顧客での増加も期待している。

メモリ関連でも、従来工程に加え、セカンドベンダーとして他工程での採用に向けた評価の機会が増加しており、他工程参入により受注高は前年比 15%程度の増加を計画している。

14. パワーデバイスは、地域別・装置別などでどのように伸ばす計画か？

A： パワーデバイスの需要が旺盛で日本・中国での設備投資が活発化している。特に中国では、ハイエンド・パワーデバイスの SiC 向けイオン注入装置、ローエンド・パワーデバイス向けの現地生産の蒸着装置への引合が強い。

日本では IGBT 向けスパッタリング装置の需要が引き続き強い。

22 年度のパワーデバイスは 19 年度比 2.8 倍の受注を計画している。

15. その他の電子関連はどの用途・地域で伸びるのか？

A： オプトデバイス関連ではメタバース・リモート活用拡大等により、日本・中国で AR/VR 用 μ OLED 投資が活発化。

また車載向けセンサー・MEMS マイクロフォンなど量産に向けた Piezo-MEMS 関連投資などが伸びる見込み。

【FPD 投資動向】

16. FPD 受注高 805 億円は前年同期 527 億円、計画 670 億円に比べて、非常に高い水準となったが、前倒し案件等があったのか、それとも急に案件が増えたのか？

A： 22 年度予定案件が 21 年度に前倒受注となったのは 40 億円程度で、他は投資の話としては認識していたものの、計画には見込んでいなかった案件が受注につながったものが多い。

特に 21 年度上期にタブレットや PC など IT パネル用 LCD 投資が想定していた以上に活発化し受注が大幅に計画を上回る結果となった。

17. LCD パネル価格の下落が続いている中、22 年度の LCD 投資計画の現実性はあるのか？

A： TV 用パネルは中国政府の支援もあり G10.5 クラスのラインが中国で複数立上り、競争が激化している一方、IT 用パネルは用途にもよるが、より高精細化・高生産性が要求されるようになり、G8.5 クラスの投資が活発化してきた。LCD 投資計画としては、中国メーカーを中心としたライン投資計画と追加投資的なものがあり、受注計画で見込んである案件は最新の顧客情報をもとに策定している。

18. アルバックのG8.5スパッタ装置での強み・競争優位性は何か？縦型・枚葉型それぞれについて教えてほしい。

A: 当社の枚葉型 G6 スパッタ装置は、パーティクルを飛躍的に削減し、G6 サイズの OLED バックプレーン用スパッタ装置として高い評価を得てきた。

枚葉型 G8.5 スパッタ装置は、G6 スパッタ装置のサイズアップで、G6 スパッタ装置のクラスター技術や装置・カソード両面からのパーティクル削減を実現した技術力を活かし、さらに AI 活用による成膜プロセス予測による安定稼働・生産性向上・省人化を実現する装置であり、

①パーティクル低減による高精細化、②生産性向上、③画面の大型化などのニーズに応える装置となり、世界初のリリースを目指している。

縦型スパッタ装置の大型基板化・サイズアップの開発は常に当社がリードしてきた。

技術的にも、真空搬送等パーティクルの最小化や高い生産性装置など最先端を走り続け、高いシェアを維持してきた。当社の縦型スパッタ装置の競争優位性は極めて高い。

19. バッテリー用巻取蒸着装置の将来のビジネス規模はどれくらいになるのか？

A: 当社はトップシェアを目指しており、将来的には数百億円程度のビジネス規模が期待できると考えている。

【コンポーネント・マテリアル・カスタマーサポート投資動向】

20. 22 年度は半導体・電子、FPD 以外にコンポーネント、マテリアル、カスタマーサポートも増加計画であるが、それぞれどのような要因で増加するのか？

A: コンポーネントはエレクトロニクス・EV 関連向けの製造装置に搭載されるポンプ・計測器・電源などが全般的に増加し、22 年度売上高は 19 年度比 1.2 倍に増加計画。

マテリアルは先端半導体向け高品質ターゲット（W・WSi 等）の増加や半導体装置と連動したターゲット（Al,Ti 等）の増加などにより、22 年度売上高は 19 年度比 1.6 倍に増加計画。

カスタマーサポートは半導体・電子の投資活発化・装置稼働率上昇により 22 年度売上高は 19 年度比 1.3 倍に増加計画。

【来期以降の業績等】

21. 来期以降の業績見込みを教えてほしい。

A: 来年 8 月には次期中期経営計画として公表予定であるが、半導体・電子・FPD を中心とした成長分野に研究開発投資を集中し、増収増益・利益率向上をさらに推進していく方針に変わりはない。

具体的な成長分野としては、先端ロジックの MHM 工程に加え、配線工程等他工程参入・他社採用による成長やメモリ向けも含めセカンドベンダー期待による他工程参入で成長していく。

電子分野は、日本や中国のパワーデバイス・各種電子デバイスの技術革新投資への対応・モジュール型装置投入や中国国産化などのチャンスを活かすことで成長する。

FPD は、大型基板 OLED のスパッタ装置やバッテリー用巻取り蒸着装置を伸ばす。

コンポーネントやマテリアルも安定ビジネス基盤として伸ばしていく。

更なる成長を実現するための経営改革にも取り組んでいく。

以上

別紙1：品目別 内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	FY2021 通期
半導体電子（億円）	817
・メモリ	3割強
・ロジック	1割強
・電子部品	3割弱
・パワー半導体	2割強
・実装	一桁台半ば
・その他	数%
FPD（億円）	805
・LCD	5割強
（大型向け割合）	（大型向け約7割）
・OLED	4割弱
・その他	約1割

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	FY2021 通期
半導体電子（億円）	678
・メモリ	3割強
・ロジック	1割半ば
・電子部品	約3割
・パワー半導体	2割弱
・実装	1割弱
・その他	-
FPD（億円）	813
・LCD	4割強
（大型向け割合）	（大型向け約8割）
・OLED	5割弱
・その他	約1割

●営業利益率順位 FY2021 通期

順位	品目
1	コンポーネント
2	半導体電子
3	一般産業
4	FPD
5	その他
6	材料

全社平均利益率は
 4) FPDと
 5) その他との間

別紙2：品目別 内訳割合

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	FY2022 計画
半導体電子（億円）	980
・メモリ	約3割
・ロジック	2割弱
・電子部品	2割半ば
・パワー半導体	2割強
・実装	一桁台半ば
・その他	-
FPD（億円）	630
・LCD	3割半ば
（大型向け割合）	（ほぼ大型向け）
・OLED	5割強
・その他	1割半ば

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	FY2022 計画
半導体電子（億円）	905
・メモリ	3割弱
・ロジック	1割半ば
・電子部品	2割半ば
・パワー半導体	2割強
・実装	1桁台半ば
・その他	数%
FPD（億円）	660
・LCD	4割強
（大型向け割合）	（大型向け約5割）
・OLED	4割強
・その他	2割弱